



達能科技公布 2010 年財務報告

年營收成長率182%

稅後每股盈餘達3.16元

2011 年 3 月 2 日，桃園訊 — 達能科技股份有限公司 (以下簡稱「達能」或「本公司」，台灣證交所股票代碼：3686) 於 3 月 2 日公布 2010 年財務報告，年營收與獲利雙創歷史新高。

重點摘要

- 2010 年整年度營業收入較去年成長 182%，達 36.1 億元
- 營業毛利率 21%，較上年度增加 22 個百分點
- 營業利益 5.5 億元，營業利益率 15%，較去年之-9%增加 24 個百分點
- 整年度每股稅後盈餘 3.16 元，較上年度之-0.97 元大幅成長

經營層報告

「由於太陽能矽晶圓產能與下游電池廠產能缺口仍大，預期2011上半年供應仍然持續吃緊，本公司2010年第四季業績持續正向成長，單季營收較前一年同期增加208%，獲利能力亦維持高水準。為了滿足下游客戶擴大的需求，擴產腳步仍在加速進行中，晶圓二廠產能200MW將於2011年第二季全數開出，擴產效益將顯現於出貨及營收成長上，今年第三季起晶圓三廠產能將陸續開出，預計年底總產能將達520MW。」

一、損益資訊

受惠於出貨增加、單價上揚等有利因素，第四季營收達 13.3 億元，較前一季成長 43%。整年度累計營收達 36.1 億元，年成長率達 182%。

第四季營業毛利 2.43 億元，較前一季的 2.19 億元，微幅增加 11%。主要是受到第四季多晶矽原料價格的上揚，致使毛利率較低於第三季。然而 2010 年整年度毛利率仍有 21.1% 之水準，較前一年度大幅增加 22 個百分點。

由於費用控制得宜，第四季營業利益較前一季成長 11% 至 1.84 億元，營業利益率 14%。整年度營業利益 5.5 億元，累計全年營業利益率達 15.4%，較前一年度成長約 24 個百分點。

第四季稅後純益 1.5 億元，較前一季增加 16%，計每股盈餘 0.98 元。2010 年整年度稅前純益 5.45 億元，稅後純益 4.79 億元。較前一年度成長約 21 個百分點以上，每股稅前盈餘 3.60 元，稅後盈餘達 3.16 元。

單位:新台幣百萬元	Q4'10	Q3'10	Q4'09	QoQ	YoY
營業收入	1,330	929	432	43%	208%
毛利率	18%	24%	8%	-5%	11%
營業費用	(59)	(53)	(29)	11%	103%
營業淨利	184	166	4	11%	4500%
營業淨利率	14%	18%	1%	-4%	13%
稅後淨利	149	128	18	16%	728%
淨利率	11%	14%	4%	-3%	7%
EBITDA	260	208	31	25%	739%
EBIT	184	160	6	15%	2967%
EPS(NTD)	0.98	0.87	0.17	13%	476%

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q4'10	Q3'10	Q4'09
現金及約當現金	1,235	1,137	195
應收帳款	231	209	67
存貨	327	277	125
固定資產淨額	3,377	2,720	1,243
短期借款	383	141	172
長期借款	1,005	564	326
負債總額	2,334	1,611	630
股東權益	3,136	2,987	1,389
總資產	5,470	4,598	2,018

截至第四季底，達能科技帳上計有現金及約當現金新台幣 12 億元。

第四季底應收帳款較前季微幅增加，主係因銷售增加所致。

第四季底存貨較前一季增加，係因預期今年第一季需求及產能持續上揚，因此增加備料。

第四季之銀行長短期借款較前季增加，主係為因應擴產所需之機器設備購置貸款。

三、營運分析

單位：%		4Q10	3Q10	4Q09
獲利能力	營業毛利率*	18%	24%	8%
	稅後純益率*	11%	14%	4%
	總資產報酬率	13%	10%	-4%
	股東權益報酬率	21%	15%	-9%
償債能力	負債佔資產比率	43%	35%	31%
	流動比率	156%	172%	220%
	速動比率	123%	135%	156%
經營能力	應收帳款週轉率(次)	24	22	38
	平均收現天數(天)	15	17	10
	存貨週轉率(次)	13	12	8
	平均銷貨天數(天)	29	31	44

*係單季數字

營業毛利率與稅後純益率略低於前一季，主係第四季多晶矽原料價格上揚所致；全年平均毛利率仍較前一年度大幅成長。

總資產報酬率及股東權益報酬率分別為 13% 及 21%，均較前一年度大幅成長。

負債比率些微增加，主係以中長期借款支應晶圓二廠的產能擴充所需之資金。

四、現金流量

單位：新台幣百萬元	Q4'10	Q3'10	Q4'09
營業活動淨現金流入	323	133	67
本期淨利	149	128	18
折舊及攤提費用	76	49	26
其他	98	(44)	23
投資活動之淨現金流出	(906)	(472)	(310)
購置固定資產	(828)	(498)	(131)
其他	(78)	26	(179)
融資活動之淨現金流入(出)	682	777	156
銀行借款	682	(66)	14
現金增資	0	840	142
其他	0	3	
本期現金及約當現金增加(減少)	99	438	(87)
期初現金及約當現金餘額	1,137	699	282
期末現金及約當現金餘額	1,235	1,137	195

第四季來自營業活動的淨現金流入為 3.2 億元，較去年同期成長 382%，主係營運擴大，獲利增加所致。

2010 年第四季之資本支出共計 8.3 億元，較前期增加，主要為擴充晶圓二廠之新產能。

五、產能進程

單位:MW	4Q10	1Q11	4Q11
晶圓一廠	120	120	120
晶圓二廠	90	200	200
晶圓三廠			200
產能合計	210	320	520

晶圓一廠年產能 120 MW 持續滿載。晶圓二廠產能為 200 MW，將於 2011 年第二季完全開出。晶圓三廠已於 2011 年一月動土，規劃總產能 200MW 將於今年年底前開出。

聯絡人

代理發言人:吳育宜財務長

發言人電郵: pr@danentech.com

<http://www.danentech.com/ir.html>

電話：+886 3 4738788

傳真：+886 3 4738368

關於達能

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽錠(silicon ingot)、太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有兩座晶圓製造廠，晶圓三廠正在興建中，預計年底前完工並投產。達能科技現有 600 位員工，經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技已順利取得數家國際太陽能電池大廠認證，未來期以成本優勢、客製化彈性及產品多樣性，成為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。